



## MSL FPGA INC 晶片參數

### ■ 芯片概述

TPA311DGN是来自MSL FPGA INC美时龙的一款低电压音频功率放大器，采用桥接负载（BTL）或单端（SE）配置，专为需要内部扬声器和外部耳机操作的低电压应用设计。

以下是其主要特性：

### ■ 核心参数

供电电压：3.3V

输出功率：在BTL 8Ω负载下可提供250mW连续功率（THD+N<1%）。

### ■ 功能特性

封装：8引脚SOIC表面贴装或PowerPAD MSOP封装，后者可减少50%板空间和40%高度。

功能特点：支持动态切换BTL/SE模式以驱动耳机，内置关断模式及消噪电路，避免开关机时的爆音。

### ■ 应用场景

适用于蜂窝通信等窄带音频应用，尤其适合小型电池供电设备（如便携式终端）。